

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-040

天津中环半导体股份有限公司 关于公司半导体材料产业进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）2021 年一季度各项工作完成进度全部达到和超过计划预期，一方面，新生产线设备调试进度缩短，在主要产品产线直通率上升的同时工厂稼动率环比进一步提高，营业收入同比、环比快速增长；另一方面，包括功率半导体材料和先进制程集成电路半导体材料在内的新产品研发、客户认证方面的工作质量和速度都较大幅度提高。结合当前全球、中国半导体产业整体发展态势和满足市场客户需求，公司将加速实施“集成电路用 8-12 英寸大直径硅片项目”既定战略规划，并提高项目产能和产品覆盖率，计划近期启动江苏宜兴二期项目建设、天津工厂扩产和新建项目，同时增大投资提升内蒙古呼和浩特晶体工厂生产配套能力。

一、半导体材料产业进展情况

产品认证情况：公司持续致力于成为全球综合产品门类最齐全的半导体材料企业，为全球客户提供全面、优质的解决方案。截至目前，产品认证直通率快速上升、新产品增量迅速，稳定的质量管控获得国内外客户认可。按应用领域来看，公司在 O-S-D 等传统优势产品领域长期布局，2020 年以来抓住了 Power、IGBT 由 8 英寸向 12 英寸转型机会，实现重点项目突破并量产，已成为该领域国内领先和国际先进的供应商。在 Logic 产品领域，多个产品配合产业链由 8 英寸向 12 英寸升级，获得灯塔客户认可，进入快速增量期；在此基础上，公司协同客户加速研发，追赶全球领先水平。在 Analog 产品领域，公司 CIS 等产品成功抓住半导体成像技术革新带来的产品升级机遇，目前 12 英寸已配合客户完成产品研发，将进入量产导入期。在 Memory 产品领域，对标国内领先的先进制程已完成内部评价，转向客户认证阶段，预计在 2021 年实现批量试产。公司完善、提升三地工厂先进性、完整性，科学、快速地拓展了 FAB 的制程能力。在原项目

设计以 8-12 英寸抛光产品基础上，根据全球和中国半导体材料、集成电路和功率半导体器件当前和未来发展态势以及客户需求，科学策划、大力推动科技研发活动，在 EPI/RTP/Ar Anneal 等新产品方面取得了圆满和超预期的科研成果实现了新产品的产业化，并在当前全球市场严重供不应求的 EPI/RTP/Ar Anneal 等新产品方面，填补了国内空白。

市场情况：2021 年一季度，在消费、工业电子升级、汽车电子、新能源汽车和新能源产业快速发展的推动下全球半导体市场持续增量，综合第三方市场分析认为半导体行业高景气度增长仍将持续 8 个季度左右。随着公司位于江苏宜兴的集成电路用 8-12 英寸大硅片项目产能爬坡顺利，公司半导体硅片产销规模持续提升，但依然整体处于严重供不应求的状态。一季度公司半导体硅片业务营收同比增长约 80%，公司预计 2021 全年将保持快速增长趋势。公司积极扩展全球化营销及服务能力，在欧洲、日本、台湾等半导体产业聚集地区积极构建市场渠道网络，打造技术支持平台，强化全球体系服务能力。

后续扩产计划：公司在内蒙古、天津、江苏三地布局半导体材料产业，目前已实现 4-12 英寸单晶硅、抛光片的规模化量产。按半导体硅片产品尺寸，公司 6 英寸及以下已有产能 50 万片/月，8 英寸已有产能 60 万片/月，12 英寸已有产能 7 万片/月；公司计划至 2021 年末，8 英寸产能将提升至 75 万片/月，12 英寸产能将提升至 17 万片/月。

为有序提升公司对各类半导体芯片的覆盖能力，在持续强化公司在各类功率半导体芯片已形成的全球先进、中国领先的优势基础上，提升对中国国内先进制程客户的服务能力，目标是进一步扩大在该领域的市场份额并在一定程度上填补国内供应链空白。公司将继续推进“集成电路用 8-12 英寸大直径硅片项目”实施，同时充分发挥混合所有制改革后企业不断提升的活力和优势，科学决策、加速启动二期项目建设，同时拟启动天津工厂扩产和新建项目，以及内蒙古半导体晶体工厂的扩产配套能力，预计 2023 年末实现 6 英寸及以下 100 万片/月，8 英寸 100 万片/月，12 英寸 60 万片/月的产能规模。

二、对公司生产经营的影响

1、随着公司半导体材料产业在自主研发能力的大幅度提高、产能规模扩充、人才梯次建立、自主人才培养和团队建设等方面已建立的优势，公司可持续发展的核心竞争力得以进一步强化，公司在全球半导体材料产业的行业地位和品牌效应初显。

2、公司将继续加速全球化商业布局，持续增强在全球市场的竞争力；通过对国内

外灯塔客户的产品配合和认证增量，逐月提升全尺寸半导体硅片产能、产量和全球和中国的市场占有率，持续增强规模效应、成本优势和盈利能力。

3、公司按照既定战略规划加速推进中环领先半导体材料各项目的实施，加快、加大投资，将促使公司的半导体材料产业科研能力提高、产品市场覆盖率上升产品产销扩大和盈利能力提高，对公司高速可持续发展产生长期积极作用。

三、风险提示

公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2021年4月27日